



**TIC™800A系列** 是一種高性能低熔點相變化導熱界面材料。在溫度50℃，TIC™800A開始軟化並流動，填充散熱片和積體電路板的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。TIC™800A系列在室溫下呈可彎曲固態，無需增強材料而獨立使用，免除了增強材料對熱傳導性能的影響。而在工作溫度下，其中相變材料軟化的同時又不會完全液化或溢出。

### 最小熱阻系列:

- 》 0.018°C-in<sup>2</sup> /W 熱阻
- 》 室溫下具有天然黏性, 無需黏合劑
- 》 流動性好, 但不会像导热膏

### 应用

- 》 笔记本电脑和台式电脑
- 》 机顶盒
- 》 内存模块
- 》 热管散热解决方案

**TIC800A 系列特性表**

產品名稱	TIC803A	TIC805A	TIC808A	TIC810A	Test Method
顏色	灰色				目視
厚度	0.003" (0.076mm)	0.005" (0.126mm)	0.008" (0.203mm)	0.010" (0.254mm)	ASTM D374
密度	2.5g/cc				氮氣比重瓶
工作溫度	- 25 °C ~ 125 °C				*****
相變化溫度	50 °C ~ 60 °C				*****
熱傳導率	2.5W/mk				ASTM D5470 (修正)
熱阻抗 @50psi	0.018°C-in <sup>2</sup> /W	0.025°C-in <sup>2</sup> /W	0.047°C-in <sup>2</sup> /W	0.058°C-in <sup>2</sup> /W	ASTM D5470 (修正)

### 標準厚度:

0.003"(0.076mm)    0.005"(0.127mm)    0.008"(0.203mm)    0.010"(0.254mm)

如需不同厚度請與本公司聯繫。

### 標準尺寸:

10" x 16"(254mm x 406mm)    16" X 400' (406mm X 121.92M) TIC™800A 系列片料供應時附有白色離型紙及底襯墊，模切半斷加工可提供拉手,也可提供模切成單個形狀型試提供。

### 壓敏黏合劑:

壓敏黏合劑不適用於TIC™ 800A系列產品。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

**加拿大:**  
Tel:+001-604-2998559  
E-mail: sales@thermazig.com

**台湾:**  
Tel: +886-2-22771007  
Fax: +886-2-22771075  
E-mail: jerry@ziitek.com.tw

**东莞:**  
Tel: +86-769-38801208  
Fax: +86-769-83791290  
E-mail: angus@ziitek.com

**昆山:**  
Tel: +86-512-57816297  
Fax: +86-512-57816327  
E-mail: kelvin@ziitek.com

**成都:**  
Tel: +86-28-62379168  
Fax: +86-28-62379168  
E-mail: david\_cd@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证.用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。